

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

的半年度评估报告

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东的利益，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、 聚焦经营主业，提升经营质量

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 以及更高速率的 DFB、EML 激光器系列产品和 50mW、70mW、100mW、150mW 等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，公司产品涵盖 1550 波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。通过持续的研发投入构建差异化竞争优势，公司从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展成为国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

2025 年上半年公司实现营业收入 20,495.09 万元，同比增加 70.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,626.39 万元，同比增加 330.31%。公司的电信

市场业务实现收入 9,987.35 万元，较上年同期减少 8.93%。公司的数据中心及其他业务实现收入 10,460.17 万元，较上年同期上升 1,034.18%。

1、持续加大研发投入，提升核心竞争力

2025 年上半年，公司持续加大研发投入，研发支出 2,673.21 万元，较去年同期增长 21.22%。公司加大了对高速率光芯片、大功率光芯片、芯片工艺等相关技术和产品的研发投入。

电信市场领域，对原有的 2.5G、10G 的 DFB、EML 产品持续加强生产过程管控，借以提升产品的良率和稳定性。随着无线和 10G PON 光纤接入部署逐步进入成熟期，行业需求增长放缓。公司在此背景下，积极配合海内外设备商提前布局下一代 25G/50G PON 所需 DFB/EML 产品，此应用需根据不同的上下行要求对应不同芯片规格，公司具备和客户一同推进方案开发的先发优势，在良好的产品匹配度下，已实现批量发货，为把握未来电信市场增长机遇奠定了坚实的基础。

数据中心领域，随着 AI 技术的快速发展，光模块正加速向高速率演进，逐步从 400G/800G 向 1.6T 等更高速率发展。报告期内，公司的 CW 70mW 激光器产品实现大批量交付，并逐步优化工艺水平。该产品采用非制冷设计，具备高功率输出和低功耗特性，适用于数据中心高速场景，成为公司新的增长极。公司推出的 CW 100mW 激光器产品，在同样具备高可靠性的前提下，通过客户的验证。公司的 100G PAM4 EML 产品已完成性能与可靠性验证，并完成了客户端验证。更高速率的 200G PAM4 EML 完成产品开发并推出，相关技术成果在 2025 年 OFC 大会上进行发表。与此同时，CPO 技术通过高度集成实现了更高的带宽密度和更低的功耗，被视为 1.6T 及以上速率的解决方案之一。2024 年，OIF 发布 3.2Tbps CPO 标准，推动行业标准化进程。公司瞄准这一机遇，研发了 300mW 高功率 CW 光源，并实现该产品的核心技术突破，以满足与 CPO/硅光集成的协同创新。针对 OIO 领域的 CW 光芯片需求，公司已开展相关预研工作。

2、加强人才队伍建设，优化人才激励机制

2025 年上半年，公司始终高度重视人才储备，随着公司业务量的进一步扩大，公司持续加强人才队伍建设，通过内部推荐、网络招聘、校园招聘等各种方

式招募优秀人才，核心团队成员稳定增长，汇聚了一支敢于自我挑战的半导体领域专业团队，为公司发展提供人才保障。经过多年积累和发展，不断优化培养机制，进行人才梳理，识别重点梯队员工进行阶梯式培养，制定职业发展规划，完善晋升通道，为员工提供不同层次、不同形式的培训机会，不断提升团队凝聚力和管理水平。结合员工岗位、工作绩效等实施员工激励，旨在吸引和留住更多优秀人才与公司共同成长，互相成就，促进公司持续发展、不断前行。

3、推进募投项目建设，提升生产制造水平

2025 年上半年，在全球算力设施建设进程加速的背景下，数据中心的需求与升级持续深化，带动数据传输量的爆发式增长，进而推动全球光模块及光芯片市场规模的快速增长。为了抓住市场机遇，满足客户对多样化产品的需求，公司进一步加大对“50G 光芯片产业化建设项目”的投资力度，积极推动产品线从传统电信市场的 DFB 产品逐步向数据中心领域的 EML、CW 光源等高速率产品转型。

在投资规模和资金安排方面，经过董事会和股东会审议，公司于 2025 年 3 月调整“50G 光芯片产业化建设项目”的投资规模，将其总投资从 1.29 亿元调增至 4.87 亿元。同时，公司将“10G、25G 光芯片产线建设项目”的节余募集资金 8200 万元和部分超募资金 2.75 亿元用于前述“50G 光芯片产业化建设项目”的投资。目前该项目正在稳步推进中，其中，2025 年上半年投入金额约为 1.28 亿元。截至 2025 年 6 月末，累计投入金额约为 2.14 亿元。

4、加强重点客户拓展，推进海外市场布局

2025 年上半年，公司进一步优化产品结构，在原有 2.5G、10G DFB 光芯片的基础上，加大 10G EML 产品的客户推广。面向下一代 25/50G PON 网络的光芯片产品实现批量交付并形成了规模收入，产品技术指标对标国际厂商。电信市场中，EML 产品已经成为重要的收入组成部分之一。公司基于多年在 DFB 激光器领域“设计+工艺+测试”的深度积累，针对 400G/800G 光模块需求，成功量产 CW 70mW 激光器芯片，在市场端加强了商务拓展，逐步进入更广泛的客户供应链。面向 PON 市场、无线市场、数通市场几大应用市场开展业务，把握人工智能带来的市场机遇，推进国内外市场的拓展和销售。以自主光芯片技术实力为驱动，通过差异化产品竞争力吸引下游头部客户，提升行业地位。为更好地服务大客户，公司

将持续投入资源加强销售体系建设，提升整体营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化的服务和解决方案。此外，公司将进一步完善全球化产能布局，有序推进海外建厂工作，提升公司在全球市场的竞争力与影响力。

二、 优化产品结构，提高经营和风险管理水平

公司根据市场需求，积极推动产品线从传统电信市场的 DFB 产品逐步向数据中心领域的 EML、CW 光源等高速率产品转型。2025 年上半年，公司在持续深耕电信市场的基础上，积极把握 AI 发展带来的数据中心市场机遇，加速完成“电信+数通”双轮驱动的高端光芯片解决方案供应商转型。在 2024 年末成功拓展了 CW 光源产品并实现了量产销售的基础上，公司进一步加大 CW 光源等产品市场拓展力度。2025 年上半年，随着数据中心业务的大幅增长，产品结构进一步优化，公司营业收入同比大幅增长 70.57%。

在产能支持方面，公司依托“50G 光芯片产业化建设项目”募投项目，在产线设计中兼容 50G、100G、CW 光源等多种高速率光芯片的生产标准要求。面对人工智能领域持续增长的市场需求，公司于 2025 年 3 月调增该项目的投资规模，同时也加大主要设备的购置力度。其中，2025 年上半年该项目已发生支出金额约为 1.28 亿元。

在运营管理方面，面对市场需求大幅增长和产品结构变化，公司在生产安排进行积极的调整，运营效率也大幅提升。2025 年上半年，公司的年化存货周转率为 1.7，相对于 2024 年上半年同比提高 32.67%。

应收账款管理方面，随着公司业务规模的提高，公司仍持续增强风险意识，加大了应收账款的管理。尤其对于逾期款项的客户，由专人进行跟进，不仅根据其信用状况控制发货规模。2025 年上半年，应收账款的结构也进一步优化。截至 2025 年 6 月末，1 年以上的应收账款占比从期初的 5.20%进一步下降至 1.86%。

在研发费用投入方面，按照年初制定的经营策略，公司在年内继续加大 EML、大功率 CW 等高速率芯片的研发投入，2025 年上半年研发费用为 2,673 万元，同比增加 21.22%。在持续的研发投入下，公司的产品结构进一步优化，数据中心在主营业务的占比逐步提高。2025 年上半年，数据中心的收入占比约为 51.04%，

已成为公司的第一大业务板块。

三、 完善公司治理，实现高质量发展

2025 年上半年，公司密切关注法律法规和政策变化，高度重视治理结构的健全和内部控制体系的建设，严格履行相关职责，规范公司运作，不断提升决策水平。具体如下：

1、完善公司治理制度，强化“关键少数”责任

2025 年上半年，为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司结合法律法规、证监会部门规章和交易所业务规则的最新规定，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度进行了修订和制定，确保了制度在公司治理工作中有效的运行，提升公司治理水平。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2025 年上半年，公司通过组织参加各类培训，及时传递监管最新政策动态及要求，持续加强董事、监事及高级管理人员的履职能力建设，充分发挥“关键少数”在公司治理中的重要作用，促进公司规范运作水平不断提升。

2、完善内控体系建设，保障公司稳健运营

2025 年上半年，公司持续推进内控体系建设，为深化各业务部门人员对内部控制的认识和理解，确保公司内控体系有效落地，内审部组织对相关人员组织开展了内控体系建设培训，并推动内控体系建设成果的实施和运行。同时，公司严格按照上市公司内控体系管理的相关要求，认真制定 2025 年内部审计计划并执行。坚持以“发现问题、改进问题、从治理机制和制度层面揭示问题”为原则，从而提高公司的经营管理能力，为高质量、可持续发展提供了有力保障。

四、 提升信披水平，加强投资者沟通

公司始终秉承“以投资者为中心”的理念，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

2025 年上半年，公司以投资者需求为导向，积极搭建与投资者沟通交流渠道，参加了“2024 年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会”和“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”。通过网络在线交流形式，积极回应市场关注，就投资者所关注的公司经营问题进行沟通，增强投资者对公司的信任和信心，且增加公司信息披露透明度。同时，公司在定期报告披露后，发布业绩报告长图，以一图读懂等形式展现，帮助投资者更轻松地了解公司的情况。

2025 年上半年，公司通过价值在线平台线上召开“2024 年年报暨 2025 年一季报业绩交流会”，由董事长、总经理及公司管理层等领导亲自出席对公司的经营成果、财务状况等信息进行详细解读，针对投资者提出的问题都给予充分的回答。同时，公司充分拓展利用上交所“e 互动”平台、投资者邮箱、投资者热线、线上或线下投资者交流会、股东会等方式，为投资者提供便捷的沟通途径，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立市场信心。

五、 以投资者为本，提高投资者回报

公司重视对投资者的回报，在确保公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的前提下，制定合理的利润分配方案，以实质回报投资者。

2025 年 6 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。实际参与分配的股本数为 85,495,577 股，派发现金红利总额 8,549,557.70 元（含税）。2025 年 7 月，公司 2024 年年度权益分派实施完成。

同时，公司为增强广大投资者的获得感，提高投资者回报力度，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和

持续发展的情况下进行中期现金分红。并已经股东会授权公司董事会，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，不断提升公司核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日